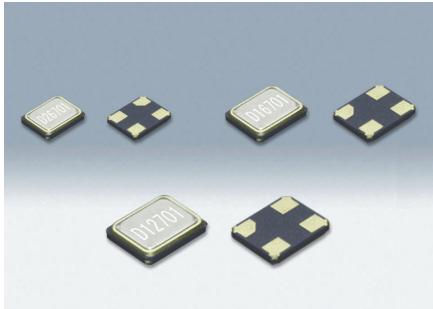


表面贴装型晶体谐振器/MHz带晶体谐振器<汽车电子用>

DSX211SH/DSX221SH/DSX321SH



实际尺寸 DSX211SH □ DSX221SH □
DSX321SH □

■ 优点

- 小型·薄型·SMD晶体谐振器 DSX211SH: 2016尺寸、厚度0.45mm
DSX221S/SH: 2520尺寸、厚度0.45mm
DSX321S/SH: 3225尺寸、厚度0.65mm
- 耐热性卓越, 高精度、高可靠性
- 支持广泛的频率 DSX211SH: 16~60MHz
DSX221S/SH: 12~54MHz
DSX321S/SH: 12~50MHz
- 依据AEC-Q200



■ 用途

- Bluetooth、无线局域网、GPS/GNSS等车载无线、多媒体设备等

■ 一般规格

项目	型号	DSX211SH		DSX221SH			DSX321SH		
频率范围		16~30MHz	30~60MHz	12~24MHz	24~30MHz	30~54MHz	12~20MHz	20~32MHz	32~50MHz
谐波次数		Fundamental							
负载电容		8pF, 10pF, 12pF							
激励电平		10μW (100μW max.)		10μW (200μW max.)					
频率公差		±30×10 ⁻⁶ (at 25°C)							
串联电阻		100Ω max.	50Ω max.	120Ω max.	50Ω max.	40Ω max.	80Ω max.	50Ω max.	40Ω max.
频率温度特性		±100×10 ⁻⁶ / -40~+125°C (Ref. to 25°C)							
保存温度范围		-40~+150°C							
可靠性规格		AEC-Q200							
包装单位(1)		3000pcs./reel(φ 180)							

(1) 无需防湿包装管理
Moisture Sensitivity Level: LEVEL1 (IPC/JEDEC J-STD-033)

有关其他规格或者特殊规格请咨询营业部门。

■ DSX211SH

■ DSX221SH

■ DSX321SH

[mm]

■ 外形尺寸

外形尺寸: 2.0±0.1 (长), 1.6±0.1 (宽), 0.45±0.05 (高), 1.275 (引脚间距), 0.975 (引脚长度), 0.575 (引脚宽度)

■ 内部连接

(Top View)
#1, #3 为晶体端子
#2, #4 与防护罩连接
#2, #4 推荐与GND连接

■ 焊盘图形(参考)

(Top View)
焊盘尺寸: 1.4 (长), 1.1 (宽), 0.9 (引脚间距)

■ 外形尺寸

外形尺寸: 2.5±0.15 (长), 2.0±0.15 (宽), 0.45±0.05 (高), 1.6 (引脚间距), 1.25 (引脚长度), 0.7 (引脚宽度)

■ 内部连接

(Top View)
#1, #3 为晶体端子
#2, #4 与防护罩连接
#2, #4 推荐与GND连接

■ 焊盘图形(参考)

(Top View)
焊盘尺寸: 1.75 (长), 1.3 (宽), 1.15 (引脚间距)

■ 外形尺寸

外形尺寸: 3.2±0.1 (长), 2.5±0.1 (宽), 0.65±0.1 (高), 2.1 (引脚间距), 1.5 (引脚长度), 0.9 (引脚宽度)

■ 内部连接

(Top View)
#1, #3 为晶体端子
#2, #4 与防护罩连接
#2, #4 推荐与GND连接

■ 焊盘图形(参考)

(Top View)
焊盘尺寸: 2.2 (长), 1.7 (宽), 1.4 (引脚间距)